

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成21年9月10日(2009.9.10)

【公開番号】特開2009-27191(P2009-27191A)

【公開日】平成21年2月5日(2009.2.5)

【年通号数】公開・登録公報2009-005

【出願番号】特願2008-261535(P2008-261535)

【国際特許分類】

H 05 K	9/00	(2006.01)
H 05 K	5/00	(2006.01)
H 01 L	25/04	(2006.01)
H 01 L	25/18	(2006.01)
H 01 L	23/28	(2006.01)
H 04 M	1/02	(2006.01)

【F I】

H 05 K	9/00	C
H 05 K	5/00	B
H 01 L	25/04	Z
H 01 L	23/28	E
H 04 M	1/02	C

【手続補正書】

【提出日】平成21年7月27日(2009.7.27)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

基板と、

前記基板に実装された複数の電子部品と、

前記各電子部品を囲うとともに前記基板に密着する枠体と、

前記枠体に備えられ、前記複数の電子部品の間にある仕切枠体と、

前記枠体の内側であって前記仕切枠体の両側に充填され、前記複数の電子部品を被覆するとともに前記基板に密着する樹脂部と、

前記枠体の開口を閉鎖する蓋部と、を備える基板構造。

【請求項2】

請求項1に記載の基板構造であって、

前記仕切枠体の下部が前記基板に密着する基板構造。

【請求項3】

請求項1又は請求項2に記載の基板構造であって、

前記枠体の上部と前記仕切枠体の上部が面一である基板構造。

【請求項4】

請求項1から請求項3のいずれかに記載の基板構造であって、

前記仕切枠体は、前記仕切枠体の両側の空間を連通する連通孔を備える基板構造。

【請求項5】

請求項1から請求項4のいずれかに記載の基板構造であって、

前記蓋部の周部にリブが設けられているとともに、

前記リブと前記枠体とが重複する基板構造。

**【請求項 6】**

請求項 1 から請求項 5 いずれかに記載の基板構造であって、

前記樹脂部に誘電性フィラーが添加されている基板構造。

**【請求項 7】**

請求項 1 から請求項 6 のいずれかに記載の基板構造を備えた電子機器。

**【手続補正 2】**

**【補正対象書類名】**明細書

**【補正対象項目名】**発明の名称

**【補正方法】**変更

**【補正の内容】**

**【発明の名称】**基板構造及び電子機器

**【手続補正 3】**

**【補正対象書類名】**明細書

**【補正対象項目名】**0008

**【補正方法】**変更

**【補正の内容】**

**【0008】**

本発明の基板構造は、基板と、前記基板に実装された複数の電子部品と、前記各電子部品を囲うとともに前記基板に密着する枠体と、前記枠体に備えられ、前記複数の電子部品の間にある仕切枠体と、前記枠体の内側であって前記仕切枠体の両側に充填され、前記複数の電子部品を被覆するとともに前記基板に密着する樹脂部と、前記枠体の開口を閉鎖する蓋部と、を備えるものである。また、本発明の基板構造は、前記仕切枠体の下部が前記基板に密着するものである。また、本発明の基板構造は、前記枠体の上部と前記仕切枠体の上部が面一であるものである。

**【手続補正 4】**

**【補正対象書類名】**明細書

**【補正対象項目名】**0009

**【補正方法】**変更

**【補正の内容】**

**【0009】**

上記の構成によれば、仕切枠体によって仕切られた枠体の内部に充填される樹脂が、電子部品を被覆しつつ基板に密着することで、基板に対する電子部品の実装強度を向上させることができる。

**【手続補正 5】**

**【補正対象書類名】**明細書

**【補正対象項目名】**0010

**【補正方法】**変更

**【補正の内容】**

**【0010】**

また、本発明の基板構造は、前記仕切枠体の両側の空間を連通する連通孔を備えるものである。

**【手続補正 6】**

**【補正対象書類名】**明細書

**【補正対象項目名】**0011

**【補正方法】**変更

**【補正の内容】****【0011】**

上記の構成によれば、枠体の内部であって仕切枠体の両側の空間を連通孔によって連通させる。

**【手続補正7】****【補正対象書類名】明細書****【補正対象項目名】0012****【補正方法】変更****【補正の内容】****【0012】**

また、本発明の基板構造は、前記蓋部の周部にリブが設けられているとともに、前記リブと前記枠体とが重複するものである。

**【手続補正8】****【補正対象書類名】明細書****【補正対象項目名】0013****【補正方法】変更****【補正の内容】****【0013】**

上記の構成によれば、蓋部の周部に設けられたリブと枠体とを重複させることで、蓋部と枠体との隙間を抑えることが可能になり、確実なシールド性が得られる。

**【手続補正9】****【補正対象書類名】明細書****【補正対象項目名】0014****【補正方法】変更****【補正の内容】****【0014】**

また、本発明の基板構造は、前記樹脂部に誘電性フィラーが添加されているものである。

**【手続補正10】****【補正対象書類名】明細書****【補正対象項目名】0015****【補正方法】変更****【補正の内容】****【0015】**

上記の構成によれば、樹脂に誘電性フィラーを添加し、この樹脂を枠体の内部に充填することで、複数の電子部品を被覆する樹脂部にシールド性が得られる。

**【手続補正11】****【補正対象書類名】明細書****【補正対象項目名】0016****【補正方法】変更****【補正の内容】****【0016】**

また、本発明の電子機器は、前述した基板構造を備えた電子機器である。